

产品结构：平面结构芯片、玻璃实体封装

产品特点：体积小，重量轻，电流小、密封性好，可靠性高

主要用途：电子电路中作开关、整流、检波用

质量等级：J

执行标准：Q/QSD20058

电特性 ($T_A=25^{\circ}\text{C}$ ，除非另有规定)

最大额定值

最高结温 T_{JM} : 175°C

贮存温度 T_{STG} : $-55^{\circ}\text{C}\sim+150^{\circ}\text{C}$

工作温度 T_{OP} : $-55^{\circ}\text{C}\sim+125^{\circ}\text{C}$

型号	V_B (V)	V_R (V)	I_F (mA)	V_F (V)	I_R (μA)	I_{FSM} (A)	I_0 (mA)	t_{rr} (ns)	外形
NIU1N4148W	100	75	10	1	5	0.5	150	5	SOD-123

